

霉菌对裸铜和镀金处理的印制电路板腐蚀行为的影响

邹士文¹, 李晓刚^{1,2}, 董超芳^{1,2}, 李慧艳¹, 肖葵^{1,2}

1. 北京科技大学腐蚀与防护中心, 北京 100083

2. 北京科技大学腐蚀与防护教育部重点实验室, 北京 100083

EFFECT OF MOLD ON CORROSION BEHAVIOR OF PRINTED CIRCUIT BOARD-COPPER AND ENIG FINISHED

ZOU Shiwen¹, LI Xiaogang^{1,2}, DONG Chaofang^{1,2}, LI Huiyan¹, XIAO Kui^{1,2}

1. Corrosion and Protection Center, University of Science and Technology Beijing, Beijing 100083

2. Key Laboratory of Corrosion and Protection, Ministry of Education, University of Science and Technology Beijing, Beijing 100083

[摘要](#)

[图/表](#)

[参考文献\(33\)](#)

[相关文章 \(15\)](#)

[点击分布统计](#)

[下载分布统计](#)

版权所有 © 2008 《金属学报》编辑部

地址: 沈阳市文化路72号, 中国科学院金属研究所(110016)

电话: +86-024-23971286, 传真: +86-024-23843760 E-mail: jsxb@imr.ac.cn

本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持: support@magtech.com.cn

美女图片

美女 美女美女 美女美女